

**東京応化工業株式会社  
決算説明資料**

**-2009年3月期決算-**

**2009年5月13日**

# 目次

1. 2009年3月期連結決算概要 p.2
2. 2010年3月期連結決算予想 p.10
3. 2010年3月期経営方針 p.16

～第3次「tokチャレンジ2 1」総括を踏まえて～

# 2009年3月期連結決算概要

# 業績概要

(百万円、%、円/ドル)

	2008/3	2009/3		
			増減	増減率
売上高	102,300	83,702	-18,598	-18.2
営業利益	8,266	-1,515	-9,782	—
経常利益	7,674	-1,534	-9,208	—
当期純利益	4,259	-4,656	-8,915	—
為替	112.5	100.9	—	—

# 事業別セグメントの業績

(百万円、%)

	2008/3	2009/3		
			増減	増減率
売上高	102,300	83,702	-18,598	-18.2
材料事業	86,071	72,495	-13,575	-15.8
エレクトロニクス機能材料	54,073	43,898	-10,174	-18.8
高純度化学薬品	27,521	24,641	-2,880	-10.5
印刷材料	4,336	3,837	-499	-11.5
装置事業	16,229	11,206	-5,023	-31.0
営業利益	8,266	-1,515	-9,782	—
材料事業	11,575	3,322	-8,252	-71.3
装置事業	1,277	-425	-1,703	—
消去又は全社	-4,586	-4,413	+173	—

# 材料事業の業績推移（四半期）

## ■2009年3月期四半期推移

（百万円）

	Q1	Q2	Q3	Q4
材 料 事 業 の 売 上	21,745	21,554	18,002	11,193
エレクトロニクス機能材料	13,853	13,244	10,341	6,459
高純度化学薬品	6,904	7,205	6,590	3,939
印 刷 材 料	970	1,061	1,023	780
営業利益（全社費用控除前）	3,201	2,469	186	-2,534

## ■前年比較

（％）

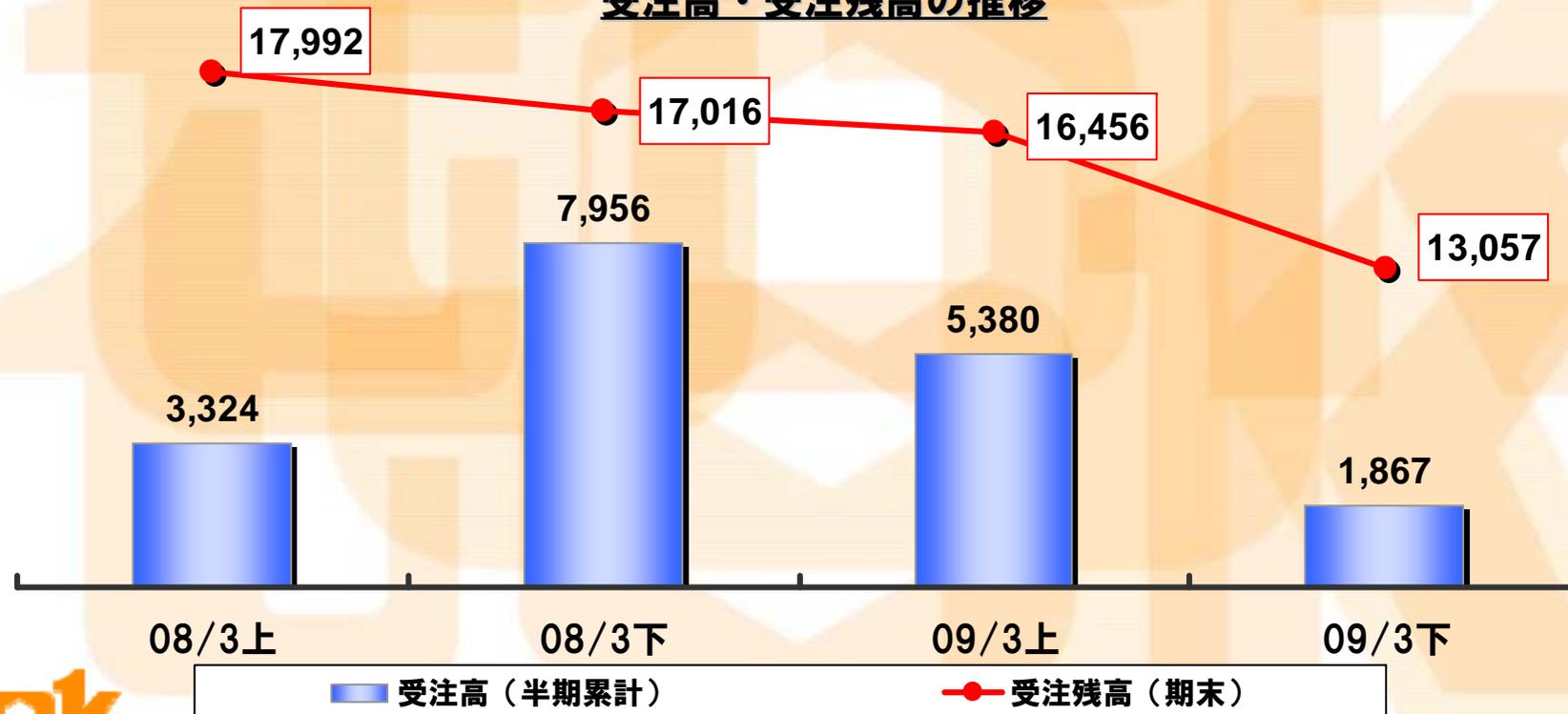
	Q1	Q2	Q3	Q4
材 料 事 業 の 売 上	+5.7	-4.2	-17.6	-47.0
エレクトロニクス機能材料	+8.3	-6.7	-25.7	-50.9
高純度化学薬品	+4.5	+0.4	-2.6	-43.5
印 刷 材 料	-14.6	-3.5	-10.7	-18.1
営業利益（全社費用控除前）	+4.6	-22.8	-94.3	—

# 装置事業の業績推移

(百万円、%)

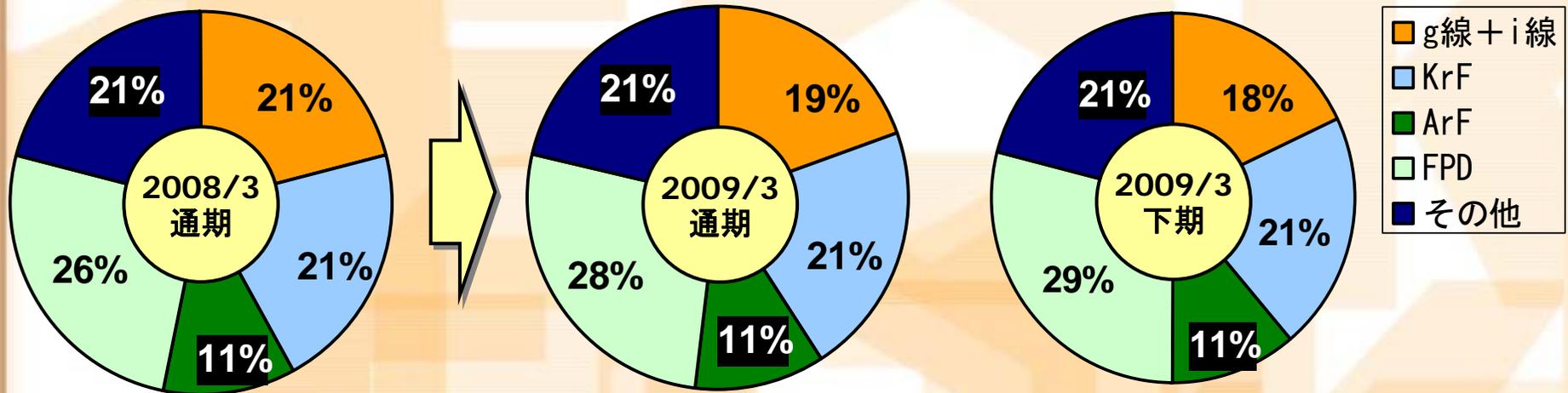
	08/3上	08/3下	09/3上	09/3下
売上高	7,249	8,980	5,940	5,266
営業利益 (全社費用控除前)	785	492	-285	-139
営業利益率	10.8	5.5	-	-

受注高・受注残高の推移

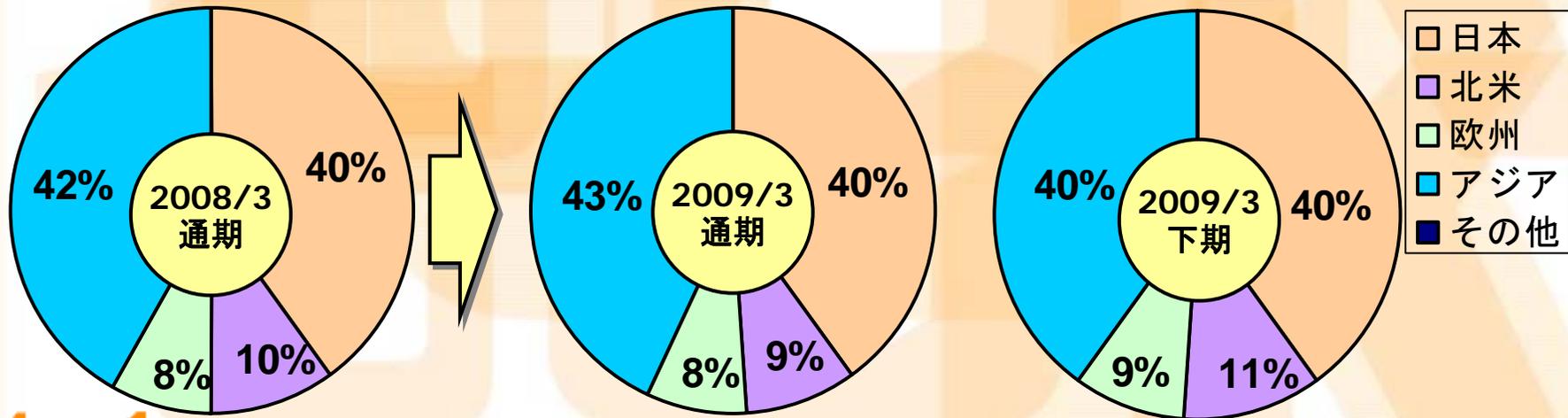


# エレクトロニクス機能材料部門の状況

## 種類別売上構成推移



## 地域別売上構成推移



# 比較貸借対照表

(百万円)

	2009/3	増減
流動資産	80,667	-14,746
内、現金預金	40,082	+1,393
有形固定資産	39,148	-6,130
無形固定資産	585	-433
投資その他の資産	18,937	+1,015
流動負債	18,755	-8,845
買入債務	7,207	-3,444
前受金	4,353	-3,610
固定負債	2,205	+6
純資産合計	118,377	-11,456
総資産	139,338	-20,294

売上債権 -13,320  
 たな卸資産 -3,557  
 ・材料事業の売上減少、装置検収進捗

設備投資 +3,270  
 減価償却 -7,297  
 減損損失 -1,874

投資有価証券 -1,467  
 ・投資有価証券の含み益減少  
 繰延税金資産 +2,572

買入債務 -3,444  
 ・生産水準の低下による仕入減少

利益剰余金 -8,223  
 自己株式 +644  
 ・自己株式の取得と消却  
 為替換算調整勘定 -2,356

# キャッシュフロー

(百万円)

	2008/3	2009/3
営業キャッシュフロー	+14,839	+10,802
税金等調整前当期純利益	+7,352	-5,325
減価償却費	+7,693	+7,297
売上債権の増(-)減額	-439	+12,020
たな卸資産の増(-)減額	+5,440	+2,745
仕入債務の増減(-)額	+667	-3,199
前受金の増減(-)額	-4,940	-3,610
法人税等の支払い	-3,007	-2,428
投資キャッシュフロー	-23,008	-2,309
財務キャッシュフロー	-3,990	-2,972
換算差額	-869	-602
現金及び現金同等物の増減額	-13,029	4,918

主な内訳

定期預金の増加	+2,762
有形固定資産の取得	-4,551

主な内訳

自己株式の取得	-1,317
配当金の支払	-1,670

# 2010年3月期連結決算予想

# 業績予想概要（通期）

（百万円、%、円/ドル）

	2009/3 実績	2010/3予想		
			増減	増減率
売上高	83,702	64,800	-18,902	-22.6
営業利益	-1,515	-4,500	-2,984	—
経常利益	-1,534	-3,900	-2,365	—
当期純利益	-4,656	-3,000	+1,656	—
為替	100.9	95.0	—	—

# 設備投資・減価償却・研究開発

(百万円)

	2008/3	2009/3	2010/3 予想	
	実績	実績		前年比
設備投資	6,574	3,270	1,900	-1,370
減価償却費	7,693	7,297	5,700	-1,597
研究開発費	8,095	8,542	8,100	-442

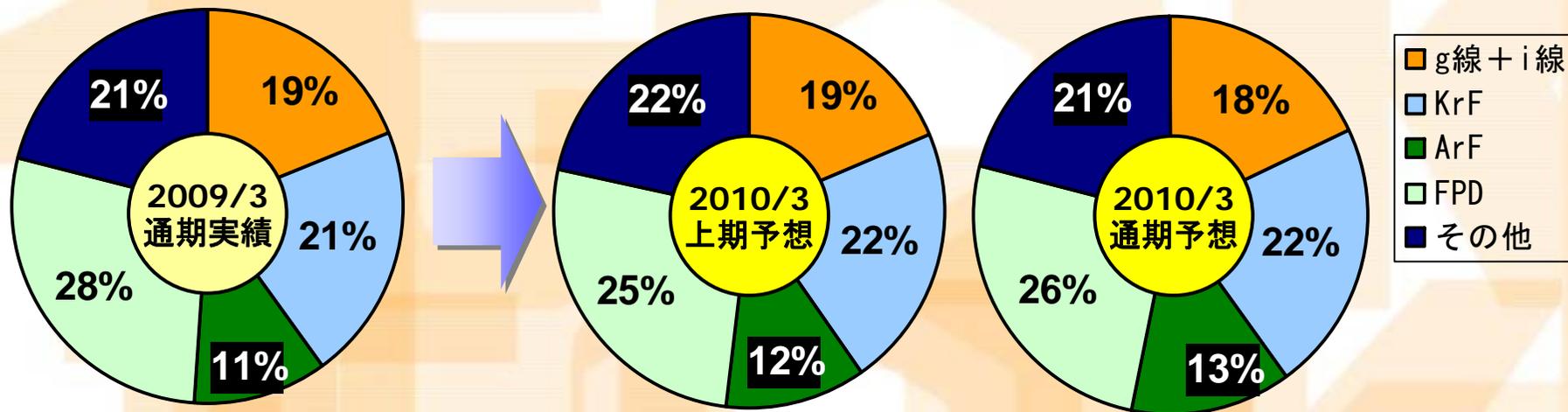
# 事業別セグメント業績予想

(百万円、%)

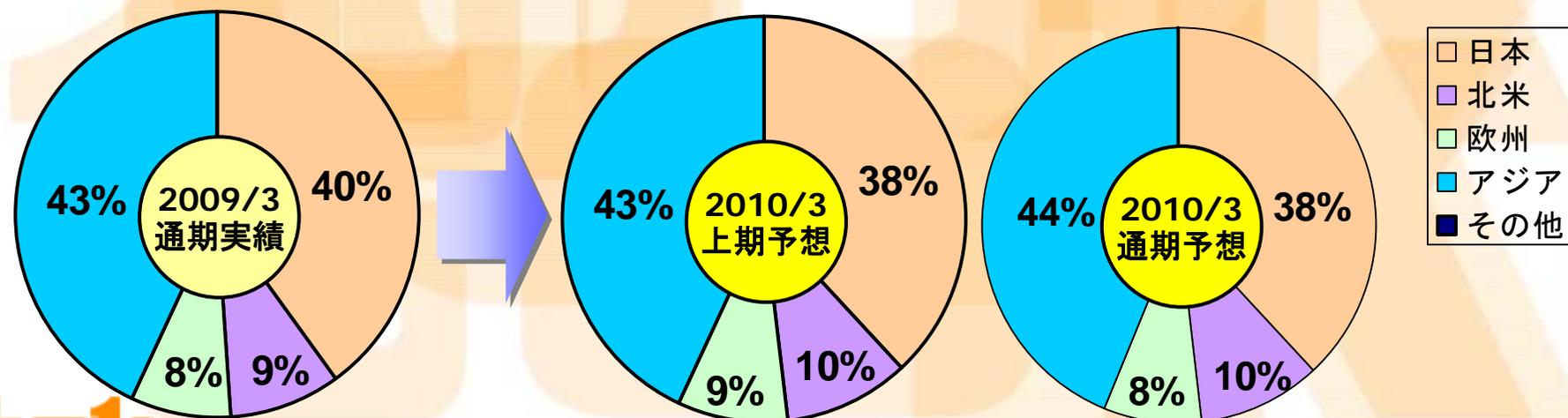
	2010/3 上期予想	2010/3通期予想		
			増減	増減率
売上高	29,900	64,800	-18,902	-22.6
材料事業	27,400	58,400	-14,095	-19.4
エレクトロニクス機能材料	16,500	35,400	-8,498	-19.4
高純度化学薬品	9,200	19,600	-5,041	-20.5
印刷材料	1,700	3,300	-537	-14.0
装置事業	2,500	6,400	-4,896	-43.3
営業利益	-3,200	-4,500	-2,984	—
材料事業	-800	200	-3,122	—
装置事業	-400	-700	-274	—
消去又は全社	-2,000	-4,000	+413	—

# エレクトロニクス機能材料部門の予想

## 種類別売上構成



## 地域別売上構成



# 地域別売上高の予想

(百万円)

	2009/3上期実績			2010/3上期予想		
		材料	装置		材料	装置
日本	19,091	17,995	1,095	13,100	11,400	1,700
北米	4,358	4,353	4	3,900	3,900	0
欧州	3,084	3,082	1	2,300	2,300	0
アジア	22,533	17,695	4,838	10,500	9,700	800

	2009/3通期実績			2010/3通期予想		
		材料	装置	通期予想	材料	装置
日本	32,378	29,841	2,536	28,100	24,100	4,000
北米	8,497	8,470	27	8,300	8,100	200
欧州	5,503	5,502	1	4,500	4,500	0
アジア	36,915	28,274	8,641	23,500	21,300	2,200

# 2010年3月期経営方針

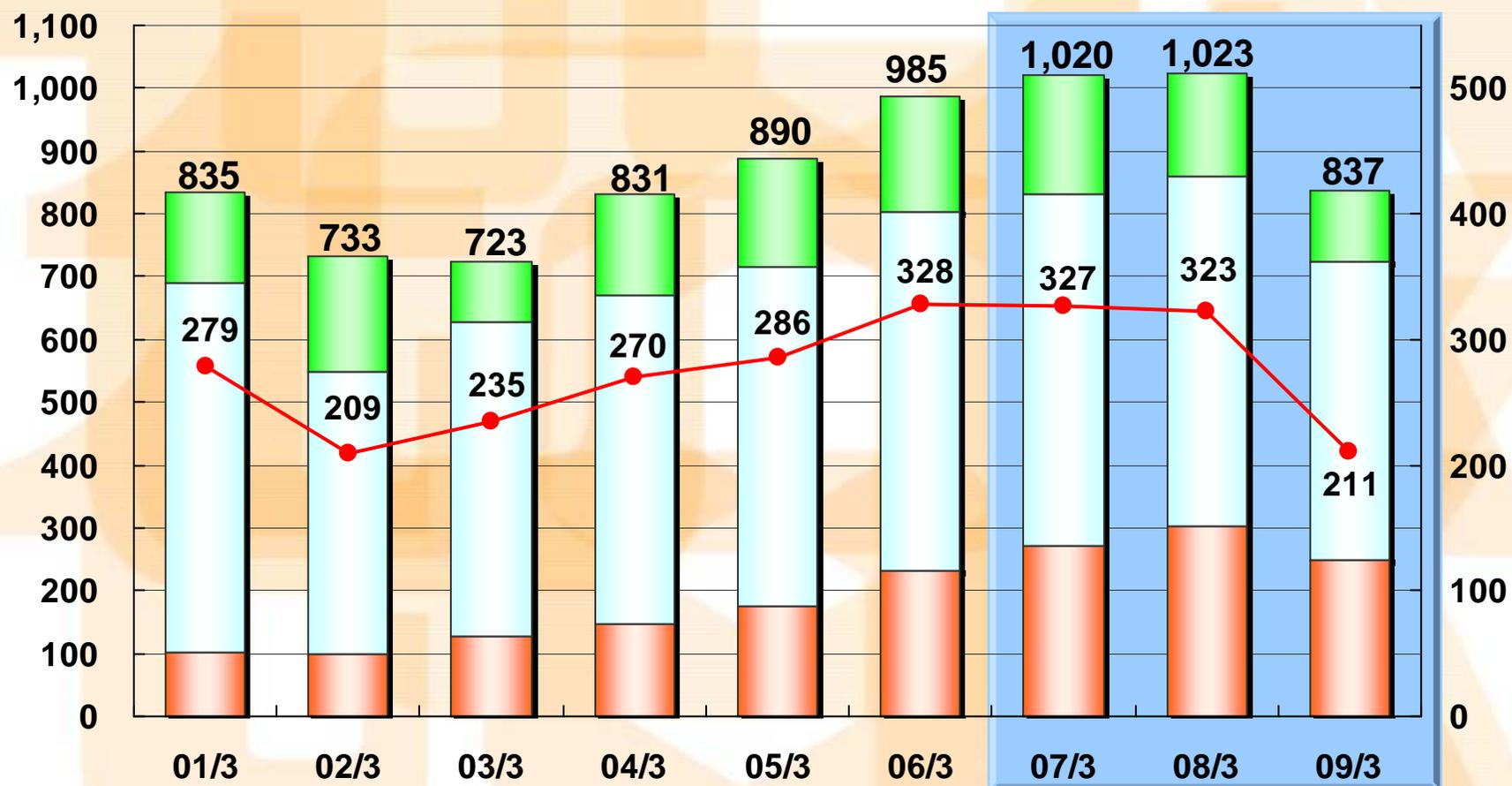
～第3次「tokチャレンジ21」総括を踏まえて～

# 第3次中計レビュー①：売上高

注力製品では成果をあげたが、売上総利益は伸び悩む

売上高(億円)

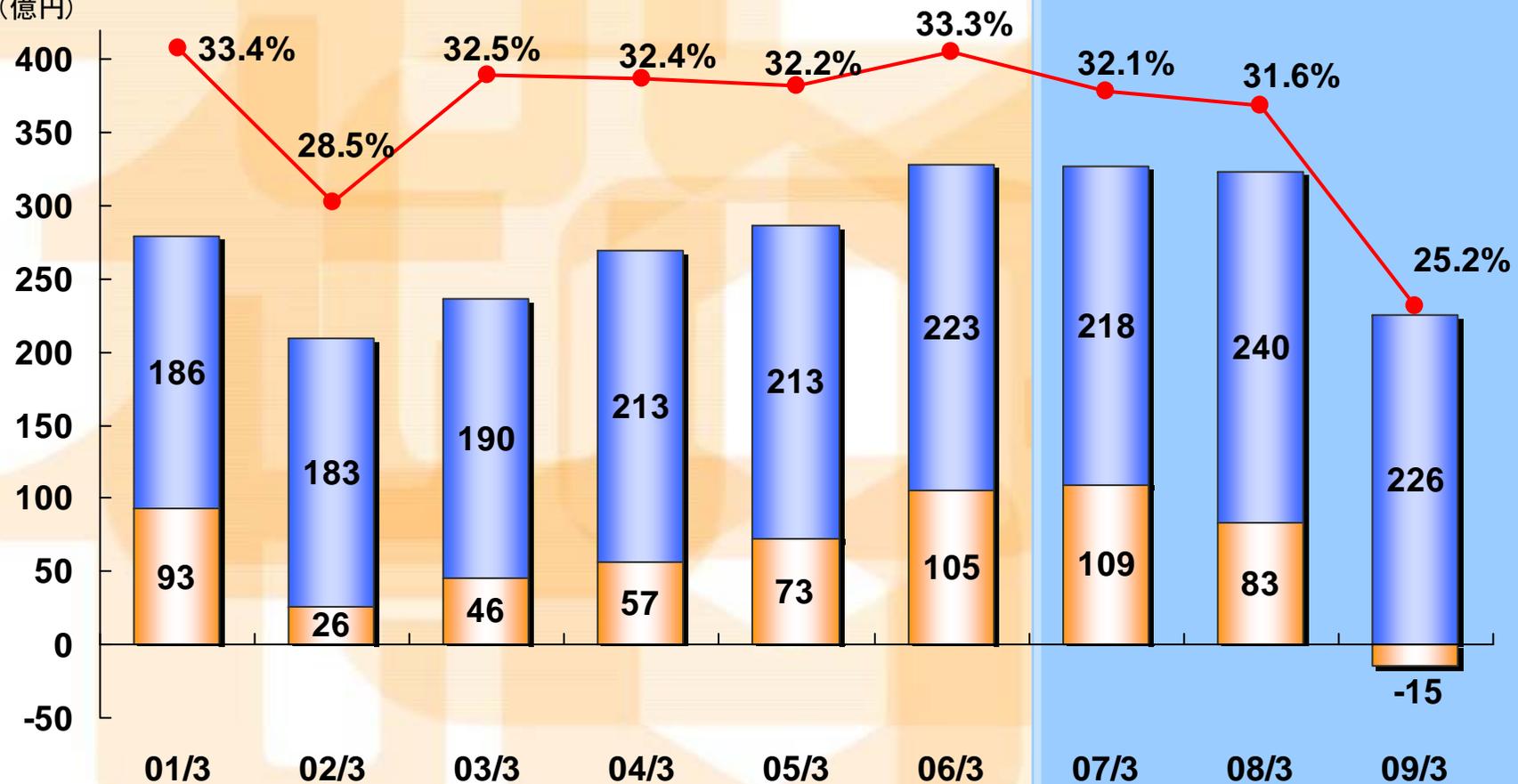
売上総利益(億円)



# 第3次中計レビュー②：営業利益

販管費の増加が、営業利益の伸びを抑制

売上総利益・販管費・営業利益  
(億円)



# 第3次中期計画の総括・今後の方針

- 固定費の見直し、削減が必要。
  - 持続的成長実現には既存事業拡大だけでは力不足。
- 
- 材料事業・・・“事業構造”の転換。
    - 成長ドライバーの構築による高収益な“事業構造”への転換。
  - 装置事業・・・“事業体質”の転換。
    - 受注の底上げ、利益のボトムラインの引上げ。
- 

## 2010年3月期経営方針

- コスト削減のため、緊急収益対策、事業構造改革を実施
- 新規事業戦略を加速
- 第4次「tokチャレンジ21」は、当分見送り

# 2010年3月期経営方針



**2011年3月期に年間約50億円のコストを削減（09/3期比）**

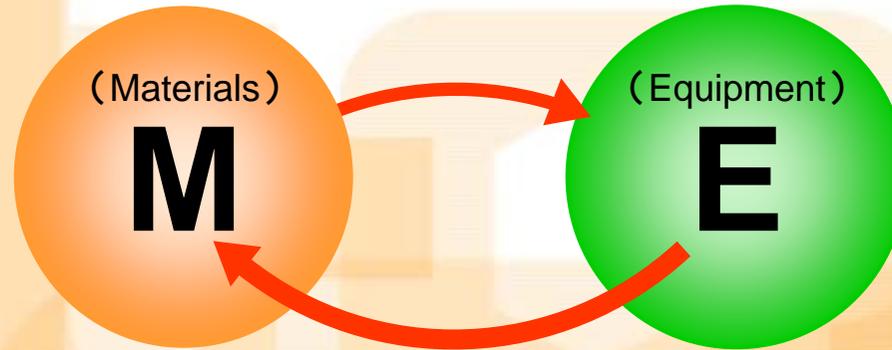
## 緊急収益対策

- 報酬・給与の減額、一時休業の実施
- 設備投資の削減（2010年3月期計画：19億円）
- その他諸経費の削減

## 事業構造改革

- 早期退職特別優遇措置の実施
- 国内製造拠点の統廃合（国内9拠点を8拠点に削減）
- 装置事業の抜本的改革

# 新規事業戦略



## 新規装置から新規材料へ



# Si貫通電極形成システム

量産装置の出荷開始、2011年3月期に売上70億円(\*)を目指す

## ■ Si貫通電極形成プロセス

(\*)材料と装置の合算金額



貼付装置



分離装置



E

M

仮止材

サポート板

深堀エッチング用レジスト

剥がし液

フォトレジスト

応用

銅めっき用レジスト

高純度化学薬品

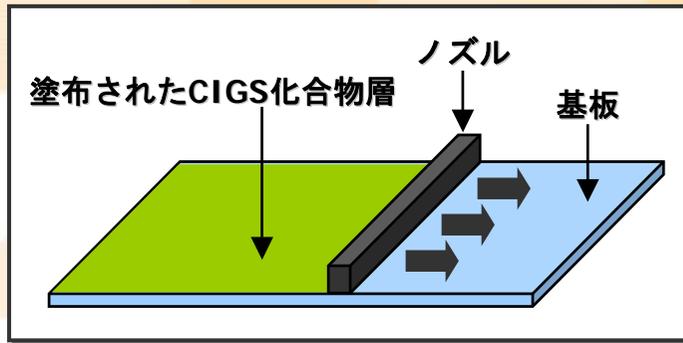
高純度化学薬品

応用

# CIGS太陽電池製造プロセス

2008年よりIBMとの共同開発を開始⇒2010年に製品化

## ■ 塗布法によるCIGS薄膜製造



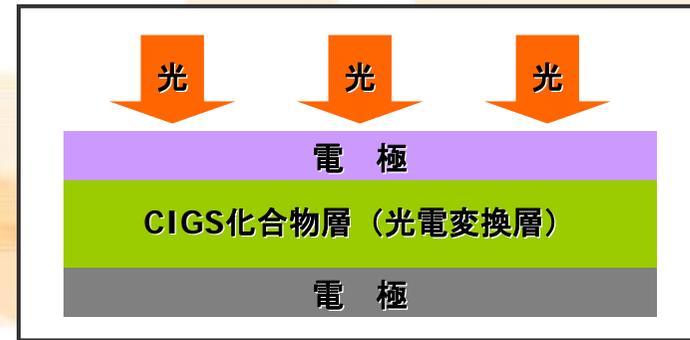
**E**  
塗布装置  
(スピンレス・コーター)

**M**  
光電変換層材料

高純度化学薬品

応用

## ■ CIGS太陽電池パネル概略図



※1 CIGS: Cu(銅)、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、セレン(Se)

※2 光電変換層: 光を吸収して電気に変換する能力を持つ層

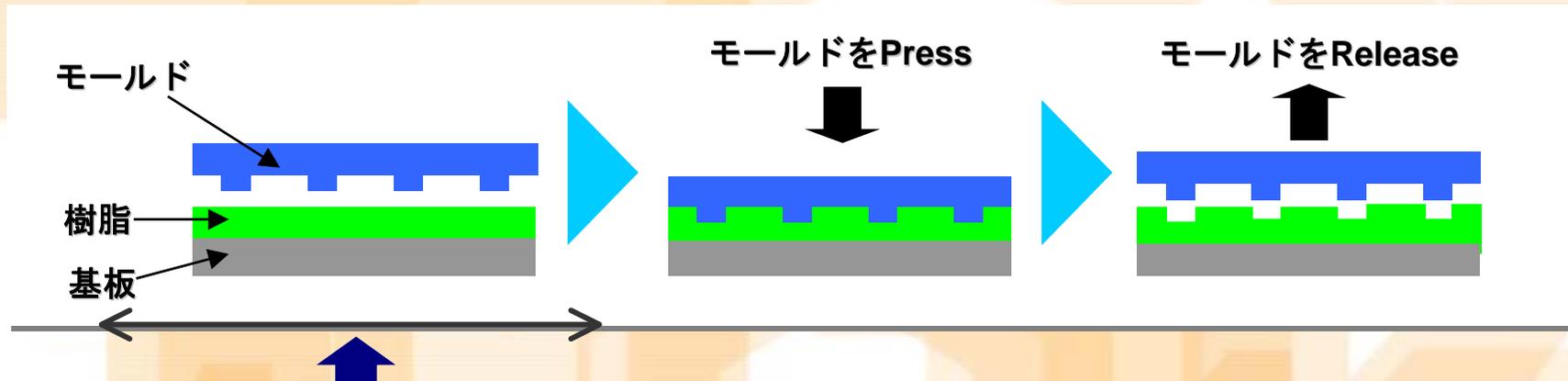
## ■ 本プロセスの特長

- 変換効率の向上 (15%以上を目標)
- 低コスト (材料の使用量低減など)

塗布装置の試作機を投入し、  
材料開発を加速

# ナノインプリント・ソリューション

次世代HDD、光学系デバイスを対象に量産装置の出荷開始



E

塗布装置  
(スピンドーター)

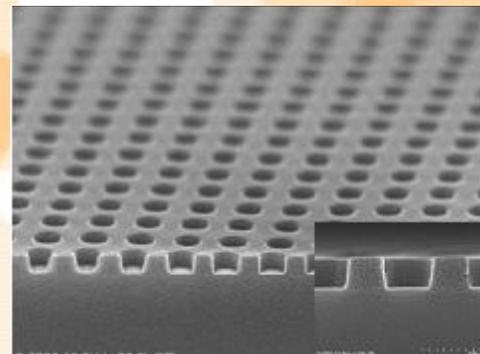


M

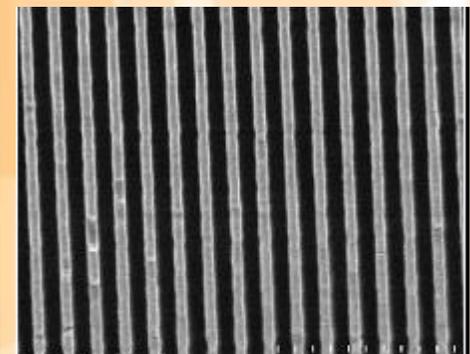
ナノインプリント材料  
(樹脂)

応用

被膜形成用塗布液



Hole Pattern ( 300nm )



L/S Pattern ( 70nm hp )

# まとめ

- 昨年秋以降の需要急減を鑑み、固定費の見直し、削減の必要性・緊急性を強く認識。
- 緊急収益対策と事業構造改革により2011年3月期には年間50億円（\*）のコスト削減を実現する。  
（\*）09/3期比の見込み額
- 第4次「tokチャレンジ21」は、既存事業の基盤強化後に開始する。
- 新規事業の創出も重要。新たに、M&Eを軸とした、新規装置から新規材料への展開を実現する。

<http://www.tok.co.jp/>

**（ご注意）**

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。